

聚辰半导体股份有限公司

关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司结合资深市场总监李圣均先生的任职履历，以及对公司音圈马达驱动芯片等多个产品线业务发展及研发项目的领导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。
- 公司原核心技术人员周忠先生因工作职责调整，不再参与具体研发项目，公司不再认定周忠先生为核心技术人员，周忠先生将继续担任本公司品质及可靠性保证部资深总监职务。
- 上述核心技术人员调整不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）结合资深市场总监李圣均先生的任职履历，以及对公司音圈马达驱动芯片等多个产品线业务发展及研发项目的领导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。同时，鉴于公司原核心技术人员周忠先生因工作职责调整，不再参与具体研发项目，公司不再认定周忠先生为核心技术人员，周忠先生将继续担任本公司品质及可靠性保证部资深总监职务。李圣均先生和周忠先生的简历如下：

1、新认定核心技术人员情况

李圣均，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，苏州大学无损检测专业理学学士。李圣均先生于 2018 年 4 月加入本公司，现担任本公司资深市

场总监职务，负责并参与本公司音圈马达驱动芯片等多个产品线的产品规划、产品研发及产品测试工作。加入本公司前，李先生于 1996 年 7 月至 1998 年 3 月任苏州第一光学仪器厂研发部助理工程师；于 1998 年 4 月至 2001 年 7 月任苏州工业园区台科电子有限公司研发部硬件工程师；于 2001 年 8 月至 2003 年 12 月任掌星科技（苏州）有限公司研发部固件开发经理；于 2004 年 1 月至 2018 年 3 月任 am-OSRAM AG 亚太区应用经理。李圣均先生拥有超过 20 年的集成电路从业经验，期间参与了多款新产品的规划与设计、测试。

在公司工作期间，李圣均先生作为第一发明人研发本公司《一种摄像头模组的电机驱动芯片底板和底板焊接结构》实用新型专利以及《降低音圈马达驱动功耗的控制装置和控制方法》、《音圈马达控制参数在线修正方法》、《芯片封装形式（WLCSP-6）》3 项在审专利，并参与研发本公司《一种宽度紧凑型半导体封装结构》实用新型专利以及《摄像头马达配置 PID 参数的控制工装、生产工站及方法》、《半导体元件封装形式》2 项在审专利。具体如下：

序号	发明名称	专利号	发明人	申请人
1	一种摄像头模组的电机驱动芯片底板和底板焊接结构	202322995118.X	李圣均、童梦舟、陈君飞、赵芬	公司
2	一种宽度紧凑型半导体封装结构	202323074599.7	陈君飞、李圣均	公司
3	降低音圈马达驱动功耗的控制装置和控制方法	在审	李圣均、陈君飞	公司
4	音圈马达控制参数在线修正方法	在审	李圣均、周航	公司
5	芯片封装形式（WLCSP-6）	在审	李圣均、童梦舟、陈君飞、赵芬	公司
6	摄像头马达配置 PID 参数的控制工装、生产工站及方法	在审	童梦舟、陈君飞、李圣均	公司
7	半导体元件封装形式	在审	陈君飞、李圣均	公司

2、原核心技术人员情况

周忠，男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，华东理工大学机电工程专业学士，复旦大学微电子专业工程硕士。2001 年 7 月至 2002 年 12 月任上海科合机电有限公司检验部主管，2002 年 12 月至 2003 年 10 月任宏茂微电子（上海）有限公司品保部主任，2003 年 10 月至 2006 年 10 月任万代半导体（上海）元件有限公司质量部高级工程师，2006 年 10 月至 2012 年 8 月任新相微电子（上海）有限公司营运部总监，2012 年 8 月至今历任公司品质及可靠性保证

部总监、资深总监职务。

截至本公告披露之日，周忠先生未作为发明人参与本公司专利的申请。

二、核心技术人员调整对公司的影响

（一）研发实力与持续经营能力

公司通过多年的自主研发及业务经营培养了一支积累了产品研发、生产工艺、质量控制等经验的稳定研发团队。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 147 人，占员工总人数比例为 50.52%。本次核心技术人员调整完成后，周忠先生将继续于公司任职，公司核心技术人员变更为傅志军、李强、王上、陈君飞和李圣均，公司核心技术人员及研发团队将持续投入对产品与技术的研发工作。

（二）专利与核心技术

截至本公告披露之日，公司研发人员在本公司工作期间作为发明人申请的专利及在审专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷的情形，本次核心技术人员调整不会影响公司专利权与核心技术的完整性。

（三）持续经营能力

截至本公告披露之日，公司已办理完成相关工作职责调整的交接，目前公司的采购、生产及销售均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生影响。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日